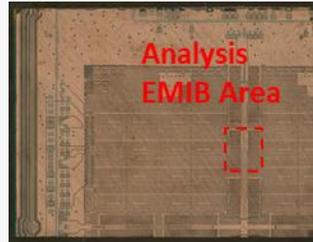
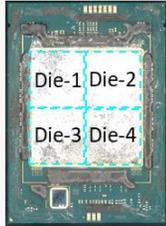


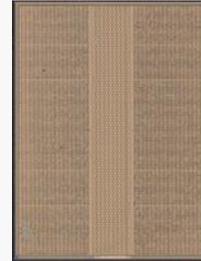
Chiplet (EMIB) : Intel Scalable Processor Sapphire Rapids Xeon Gold 6430 EMIB解析レポート



Xeon Gold 6430



PKG PCB



EMIB

概要

CPU/GPUにおいて、1チップ内に設けるコア数に限界があり、各社コア数を増やすため、複数のチップをインターポーザーで繋ぎIC間の高速通信を行っています。チップ間接続はこれまで広面積のインターポーザーを介して接続するのが主流でしたが、近年は複数チップ間を局所に設けたインターポーザーで接続するSilicon Bridgeも増えています。

本レポートでは、Silicon Bridge (EMIB) を介したチップ間の接続経路および、PKG基板からの電源供給経路を明確にした (Die-1 ~ Die-2 間にあるEMIBの代表1チップを対象に解析しました)。

製品特徴

- ・Coax MIL [coaxial magnetic inductor loops] と呼ばれる新タイプの磁気コアインダクタを使用
- ・4枚のチップをEMIBで接続している3D構造

解析内容

- ・PKG基板各層除膜/経路
- ・EMIB各層除膜/接続経路
- ・PKG基板の電源ラインとEMIBへの接続経路確認 (代表箇所)

レポート価格

価格: ¥1,950,000 (税抜)

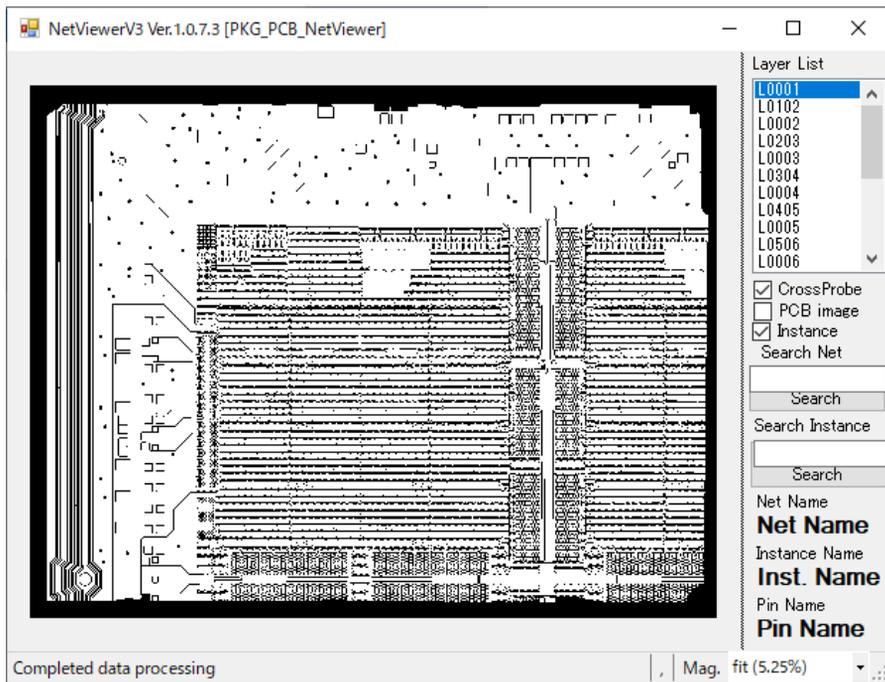
納期: 発注後1weekで納品

Table of Contents

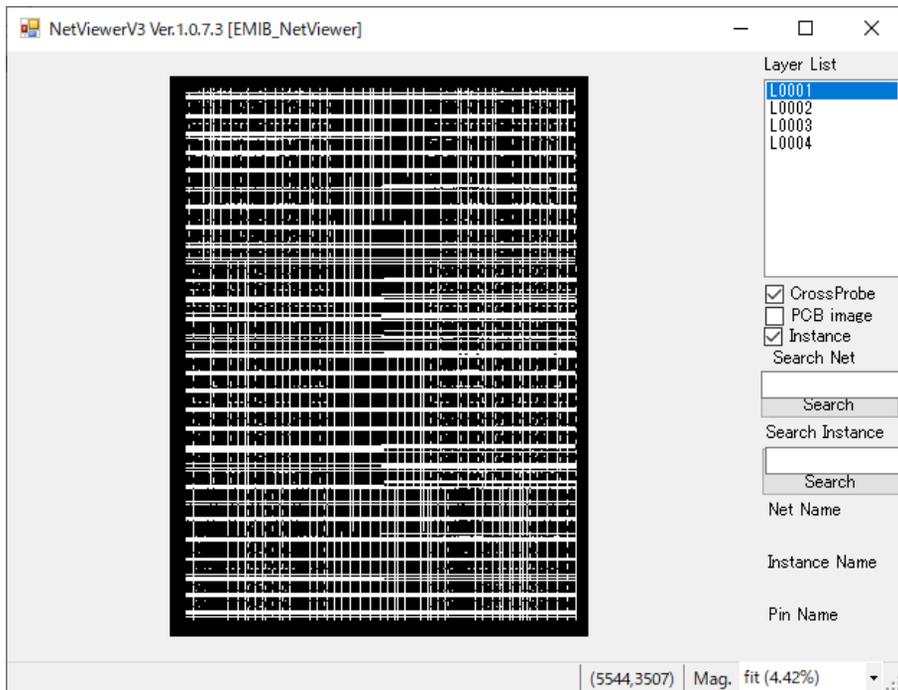
		Page
Summary	3
1. Product Overview	4
2. Substrate after heat sink removal	5
3. PKG Delayer	6
4. EMIB Delayer	12
5. Connection Information	14



PKG PCB及びEMIBの接続情報が確認できるViewerを提供します。
下図は各Viewerより抜粋。



PKG PCB Viewer



EMIB Viewer

